

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴



深圳市迅捷兴科技股份有限公司

Shenzhen Xunjiexing Technology Corp.Ltd.

(深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A
座 24 楼)

2026年度以简易程序向特定对象发行A 股股票募集资金投向属于科技创新领域 的说明

二〇二六年五月

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“迅捷兴”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况，对募集资金投向属于科技创新领域进行了研究并编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的 PCB 需求。

目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的 PCB 企业。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次募集资金使用计划

本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 13,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	信丰高多层、HDI 产线技改与升级项目	10,550.40	9,500.00
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		14,050.40	13,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需

求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

（二）本次募集资金投资项目可行性分析

1、信丰高多层、HDI 产线技改与升级项目

（1）项目概况

类别	内容
项目名称	信丰高多层、HDI 产线技改与升级项目
实施主体	信丰迅捷兴电路科技有限公司
项目总投资	10,550.40 万元
项目建设内容	在信丰生产基地进行高多层、HDI 产线技改与升级项目的建设，扩大应用于服务器、光模块、网络通信等算力基础设施及汽车电子等领域的高多层板与高密度互连（HDI）印制电路板生产规模
建设地点	信丰工业园绿源大道南侧，江西信丰电子器件产业基地内

（2）项目实施的必要性

①顺应 PCB 行业高端化趋势，抢占核心增长赛道

当前，全球 PCB 产业正由规模扩张向结构优化转型，低端产品需求趋弱，高端化进程持续加速，其中高多层板、HDI 板已成为引领行业增长的核心品类。对公司而言，加快布局高多层板、HDI 板等高端产品，是实现增长曲线跃升的战略支点，也是在本轮产业变革中巩固竞争根基的必由之路。

从行业数据来看，高端 PCB 赛道景气度显著。据 Prismark 统计，2025 年高多层板、HDI 板产值同比增幅分别为 18.2%和 25.6%，均为 PCB 细分领域中增速领先品类；中长期看，2024-2029 年两者复合增长率预计分别达 9.0%和 11.2%，高端化发展趋势明确。

从需求端看，高端 PCB 的增长逻辑清晰、动能充足。AI 算力基础设施、高速网络通信、智能电动汽车等新质生产力领域持续放量，构成高端 PCB 需求扩张的关键支撑。AI 服务器及配套 EDSFF 存储设备的规模化部署需要高密度、高功率、高可靠的硬件架构升级，对 PCB 的层数、材料及精密加工工艺提出更高要求，直接推动行业向高密度化、高集成化演进；以 800G/1.6T 高速光模块为代表的超高速光通信设备，对 PCB 的线宽线距、阻抗控制及信号完整性提出严苛要求，驱

动 PCB 制造向超高密度互连、高频高速方向升级。

②突破高端产品工艺壁垒，构建长期核心竞争力

高多层板和 HDI 板，尤其是应用于服务器、光模块等领域的高端产品，其制造工艺复杂，是融合材料学、精密加工、信号完整性设计等多学科的系统工程。

从工艺要求来看，高多层板需同步攻克“高密度”与“高性能”两大难题，层数提升对层间对准度、阻抗一致性、散热性能及长期可靠性提出综合高要求；HDI 板技术壁垒集中于“微盲孔/埋孔高密度互连”，通过微孔技术替代传统通孔提升布线密度，高阶 HDI 需循环层压、激光钻孔、微孔电镀等工序，工艺难度随阶数呈指数级上升。

本次募投项目采用的先进技术，可将线宽线距公差控制在更小范围，实现微米级精细线路加工、精密孔径控制与高平面度管控，满足下游应用对超高密度、超低信号损耗及高可靠性的严苛要求，推动公司技术能力实现质的飞跃，从而构建起公司的核心竞争力。

③依托 AI 算力产业机遇，打开高价值增长空间

当前，生成式 AI 驱动的科技革命正重塑全球算力基础设施格局，为上游 PCB 供应商打开了结构性、高附加值的增量窗口。公司布局高多层板和 HDI 板，意在推动客户结构从安防、工业控制等传统优势领域，向 AI 算力等前沿赛道延伸，抢占产业升级红利。

AI 服务器高速传输依赖高性能连接器，AI 集群向万卡/十万卡升级带动高速连接器速率向 112Gbps、448Gbps 迭代，叠加 EDSFF 规格产品规模化应用，直接拉动高端 PCB 需求升级。EDSFF 企业级存储凭借高存储密度、强散热能力及对 PCIeGen5/6 协议的适配性，加速替代传统存储方案，成为高端 SSD 与服务器硬件主流形态，直接带动 PCB 需求结构性升级。与此同时，1.6T 光模块的规模化商用对 PCB 提出了全新的技术需求。光模块从 800G 向 1.6T 升级，要求 PCB 具备更高的讯号完整性、更精细的线路及更高的散热能力，这直接推动了新技术在 PCB 板级的应用。

公司要成为 AI 服务器领域的核心供应商，需拥有规模化的高端产能和经过

认证的稳定制程能力。本次募投项目将提升公司生产批量高多层板和高阶 HDI 板的能力，是公司成为 AI 服务器领域核心供应商的关键。

④契合国家产业战略导向，助力高端制造与产业链自主可控

公司募投项目的战略定位与国家推动制造业高端化、智能化发展的方向高度一致，充分响应了增强产业链供应链自主可控能力的政策导向。

高多层板和 HDI 板是电子信息产业不可或缺的基础核心部件，其技术水准直接关系到 5G 通信、人工智能、数据中心、新能源汽车、网络通信等战略性新兴产业的发展质量与安全韧性。当前，全球高端 PCB 产能呈现高度集中态势，主要分布在中国台湾、日本、韩国等地区的少数领先厂商。中国大陆 PCB 产业虽已实现规模全球第一，但在高端产品领域仍存在明显短板，中低端占比偏高。加速本土 PCB 企业向高多层、高阶 HDI 等高端赛道突破，是夯实电子信息产业根基、实现科技自立自强的重要战略支点。

⑤满足高端产能建设资本需求，保障设备升级与先进产能落地

高端 PCB 制造是典型的技术密集型和资本密集型行业。从普通多层板向高多层、高阶 HDI 跃迁，需投入重金新建或改造厂房，并购置系列专用生产设备，本次募集资金是确保这一资本开支顺利落地的关键保障。

设备投资是高端 PCB 产能建设中占比最高的支出项目。以高多层板和高阶 HDI 板为例，随着层数增加、阶数提升及材料迭代，钻孔效率明显降低，同等产出规模下设备需求量上升，且对高精度钻孔机的依赖加剧。若完全依赖经营积累滚动投入，现金流将被严重拖累，更可能因产能建设周期过长而错失市场爆发的时间窗口。借助资本市场进行股权融资，既能缓解短期财务压力，又能加速长期战略落地，是快速构建先进产能、抢占市场先机的最优路径。

（3）项目实施的可行性

①核心技术积累深厚，支撑高端产能工艺升级

自成立以来，公司发展战略始终聚焦于样板、小批量，致力于为客户提供从样品研发到中试再到量产的一站式服务，在技术领域形成了深厚的积累，这为其

向更高层次的高多层板和 HDI 板业务拓展提供了坚实的技术支撑。

从研发体系与成果来看，公司已建立起成熟的创新机制，并获得了权威认可。公司是国家高新技术企业，深耕 PCB 样板和小批量板行业多年，形成了完善的技术体系。为满足不同领域客户不同产品差异化的需求，积累了光模块板生产技术、多种镀厚金板生产工艺技术、盲埋孔板（HDI）生产技术、厚铜电源板生产技术、高频板、高速板生产技术、服务器板生产技术、高精密多层板生产技术、毫米波雷达板生产技术等多项 PCB 生产核心技术。公司拥有的核心技术均为自主创新，多项核心技术处于行业或国内先进水平，并已全面应用在各主要产品的设计当中，实现研发成果的有效转化。截至 2025 年末，公司已经取得授权专利 221 项，其中发明专利 47 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

从数字化制造基础及经验来看，公司已在珠海工厂及信丰二厂打造了 PCB 数字化智能工厂，数字化智能工厂利用 ERP、MES、EAP、WMS、APS、SCM 及企业跨系统集成平台 ESB 系统集成大数据管理，通过工厂自动化设备互联互通，实现工厂全流程管理的数字化和透明化。公司未来拟将成熟数字化制造经验平移至本项目进行应用。

②一站式服务优势、头部客户资源、互联网接单端口构成强大市场准入壁垒

公司一站式服务优势、头部客户资源、互联网接单端口构成了公司进军高多层板和 HDI 板市场坚实的护城河和可行性保障。

首先，国内 PCB 市场格局呈现“大批量主导、样板稀缺”的特征，能够实现从样板到批量一站式延伸的企业屈指可数。公司已构建样板、小批量板、大批量板协同发展的业务体系：对大批量企业而言，公司的样板业务是前置获客的独特优势，可更早触达客户研发需求；对样板或小批量企业而言，公司的大批量产能是一站式服务的核心支撑，确保客户产品定型后产能无缝切换。

其次，公司战略性聚焦智能安防、工业控制、汽车电子、人工智能等高景气赛道，围绕大客户及潜在大客户展开深度运营，通过审厂、复审等机制加速订单转化，实现样板到批量的量质齐升。核心客户矩阵包括海康威视、大华股份、NCAB GROUP、视源电子、Würth（伍尔特）、北斗星通、道通科技、锐明技术、富鼎精

密、迈瑞医疗等国内外知名企业，为公司长期稳健发展提供有力保障。

最后，互联网在线接单平台为市场拓展提供流量入口。公司推出电子商务平台，实现 PCB 生产在线询价、DFM 可制造性分析、在线下单、款项支付、订单管理及进度查询、在线售后服务等功能，有效覆盖和满足市场容量广阔的长尾需求。互联网在线接单平台为行业内为数不多的品牌在线接单平台，为公司及产品知名度的积累与提升提供了良好助益。在本项目未来投产后，互联网在线接单平台亦可以为本项目相关产品提供线上订单支持。

③专业人才体系完善，保障项目高效落地

多年经营积累使公司形成了一支稳定、专业且具备深厚行业积淀的管理团队。核心员工长期在 PCB 企业从事生产、技术、销售、管理工作，对电路板制造工艺及品质管理理念有深刻把握，熟悉客户内部流程与管理范式，能够开展精准高效的沟通协作。公司注重人员结构稳定，并通过股权激励机制持续强化人才吸引力与绑定度，提升员工对公司的认同感与归属感。

公司工程自动化系统的搭建在减少公司对工程技术人员依赖的同时，可极大提高 PCB 制程效率、精度和可靠性，降低制造成本，提升产品竞争力。工程自动化系统可实现自动报价、自动预审、自动 EQ、CAM 文件自动处理、智能合并、生产资料自动生成等功能，使订单快速进入生产排产环节。工程自动化系统的搭建和使用经验未来可以在本项目中进行有效复制及利用。

④下游需求高速增长，支撑新增产能消化

市场需求方面，AI 服务器单台存储容量可达通用服务器的 3 倍以上，带动 EDSFF 产品需求持续攀升。据 Prismark 统计，2025 年 EDSFF 带动 PCB 需求超 18 亿美元，同比增长 70%，预计 2029 年需求将达 65 亿美元，2025 至 2029 年复合增速预计达 36%，显著高于行业增速。

光模块承担着算力信号高速传输的核心功能，其市场需求随 AI 算力密度提升呈现快速增长态势。从市场规模来看，据 LightCounting 等预测，2025 年全球光模块市场规模超 230 亿美元，同比增长 50%，其中 800G/1.6T 高速光模块成为增长重心。2026 年全球光模块市场规模预计达 180-300 亿美元，同比增长

35%-43%，且 1.6T 光模块已进入量产元年，2026 年出货量预计突破 2000 万只，硅光方案占比达 80%。从需求驱动来看，AI 训练组网架构升级、海外科技巨头加大 AI 投入，叠加 CPO 产业加速落地，持续放大光模块需求，其规模化应用直接带动高频高速 PCB 需求扩容，为 PCB 行业带来显著增量。

AI 电源是 AI 服务器、智算集群稳定运行的核心保障，涵盖服务器电源、DC-DC 转换模块等品类。从市场规模来看，据相关数据显示，2024 年全球 AI 服务器电源市场销售额约 28.46 亿美元，预计 2031 年将达 608.1 亿美元，2025-2031 年复合年增长率高达 45%；仅 AI 服务器 AC-DC 电源领域，2025-2032 年复合增长率也达 21.1%，整体市场空间广阔。需求端，AI 服务器功率较普通服务器高 6-8 倍，高功率、高效率二三次电源成为主流，叠加新一代供电技术落地，持续拉动需求扩容，其规模化应用直接带动配套 PCB 需求增长，成为 PCB 行业重要增量。

（4）项目投资概算

本项目总投资金额为 10,550.40 万元，本次拟使用募集资金投入 9,500.00 万元，项目投资结构如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资的比例
1	设备购置及安装费用	10,454.80	99.09%
2	建筑工程费用	95.60	0.91%
合计		10,550.40	100.00%

（5）项目涉及土地、备案、环评审批情况

本项目建设地点位于信丰工业园绿源大道南侧，江西信丰电子器件产业基地内。项目占地 8,681.00 平方米，建筑面积 27,401.22 平方米，公司已取得该处国有土地使用权。

截至本说明出具日，本项目的备案手续尚在办理中；本项目无需重新办理环境影响评价手续。

（6）项目经济效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，项目预期效益良好。

2、补充流动资金

(1) 项目基本情况

公司计划将本次募集资金中的 3,500.00 万元用于补充流动资金，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

(2) 项目的必要性

从行业发展趋势与竞争格局变化来看，公司业务规模近年来不断扩大，未来几年仍处于成长阶段，生产经营、市场开拓、研发投入等日常运营对营运资金的需求显著增加。本次发行募集资金用于补充流动资金，可在一定程度上匹配业务扩张节奏，缓解资金压力，优化财务结构，提升抗风险能力与整体竞争实力。

(3) 项目的可行性

①本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次以简易程序向特定对象发行募集资金用于补充流动资金，符合现行法律法规及监管要求，方案切实可行。募集资金到位后，将有效改善公司资本结构，降低财务风险；面对日益激烈的行业竞争，营运资金的补充能够缓解业务拓展带来的资金压力，为公司持续、健康、快速发展提供保障，符合公司及全体股东的根本利益。

②公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规范运作要求，构建了完善的公司治理体系，建立健全了各项规章制度和内部控制制度，并在生产经营实践中持续改进和优化。公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批程序、使用方向、日常管理及监督机制予以明确规范。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

(一) 本次募集资金主要投向科技创新领域

本次募集资金投资项目为信丰高多层、HDI 产线技改与升级项目及补充流动资金项目，资金投向围绕主营业务进行。公司主营业务为印制电路板的研发、生

产与销售。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”，符合国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。

（二）募投项目促进公司科技创新水平提升

1、突破高端产品产能瓶颈，优化产品结构布局

当前公司 HDI 及高多层板等高端产品产能相对有限，难以充分满足下游客户日益增长的研发创新与批量交付需求。通过本次募投项目建设，公司将系统性扩充高阶 HDI 及高多层板生产能力，引进适配高端制程的先进设备，完善全流程工艺体系。项目投产后，公司高端产品产能将得到显著释放，有效缓解当前高阶产品产能不足的瓶颈约束，推动公司产品结构向更高技术含量、更高附加值的 HDI 及高多层板领域加速升级。

2、对接下游高端应用需求，驱动核心技术持续迭代

随着下游通信、汽车电子、人工智能及高性能计算等领域技术迭代加快，市场对 HDI 及高多层板的集成密度、信号传输性能及可靠性要求持续提升。募投项目建成后，公司将更好的满足下游行业龙头客户在高端产品的技术要求。通过深度嵌入下游高端应用的创新链条，公司将不断推动 HDI 高密度互连技术及高多层板复杂层压、精细线路等核心工艺的创新迭代，形成需求牵引与技术突破的良性互动。

3、提升高端产品工艺水平，增强中高端市场竞争力

近年来，全球 PCB 产业中高端产能持续向中国大陆转移，高阶 HDI 及高多层板市场份额加速向具备先进制程能力与稳定交付水平的优势企业集中。本次募投项目通过继续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品产能及技术水平，将显著提升公司高端产品的工艺稳定性与批量交付能力，进一步推动公司生产及技术能力完成质的飞跃，从而构建起公司的核心竞争力。项目建成后，公司承接高阶 HDI 及高多层板订单的能力将大幅增强，有助于公司积极拓展国内外中高端客户群体，提升在高端 PCB 市场的竞争地位。

综上，募投项目投产后，公司将建成以高阶 HDI 和高多层板为核心、具备行业先进制造水平的 PCB 高端生产基地，系统性突破高端产品产能与工艺瓶颈，实现产品结构向中高端领域的战略转型，为公司长期高质量发展与技术创新领先提供坚实保障。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日